

先進メモリのパイオニア

DuraMemory™ / DuraFlash™
Zefr™ Memory / Data Center SSDs / CXL™ Memory

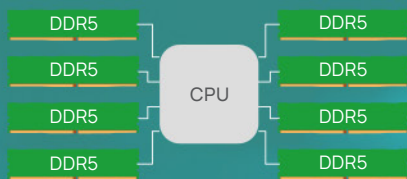


CXL™ メモリモジュール

最適化されたコンピューティングのためにメモリプールを有効にする

DDR5 DIMM を使用する場合

SMART DDR5 チャンネル: 48GB/秒の帯域幅
SMART DDR5 DIMM: DIMM あたり 128GB



合計帯域幅

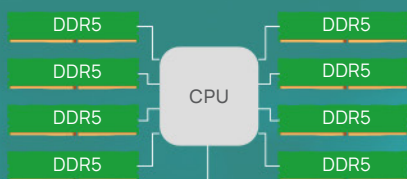
384 GB/s

合計容量

1 TB

CMM-E3S を使用する場合:

SMART DDR5 チャンネル: 48GB/秒の帯域幅
SMART DDR5 DIMM: DIMM あたり 128GB



合計帯域幅

640 GB/s

1.66 up ↑

合計容量

1.5 TB

1.5 up ↑

CXL 2.0 メモリ拡張ソリューション
各 128GB 容量

32GT/秒で動作する PCIe-Gen5 速度と
互換性のある CXL 2.0

64GB DDR5 メモリ容量で利用可能で、
将来的には最大 256GB まで拡張する予定

CXL 2.0 に追加された信頼性、可用性、保守性
(RAS) 機能をサポート

遅延を改善し、コヒーレントメモリをキャッシュし、
コンピューティングの性能と効率を向上

メインメモリ DIMM モジュールを超える追加の
容量と帯域幅を提供

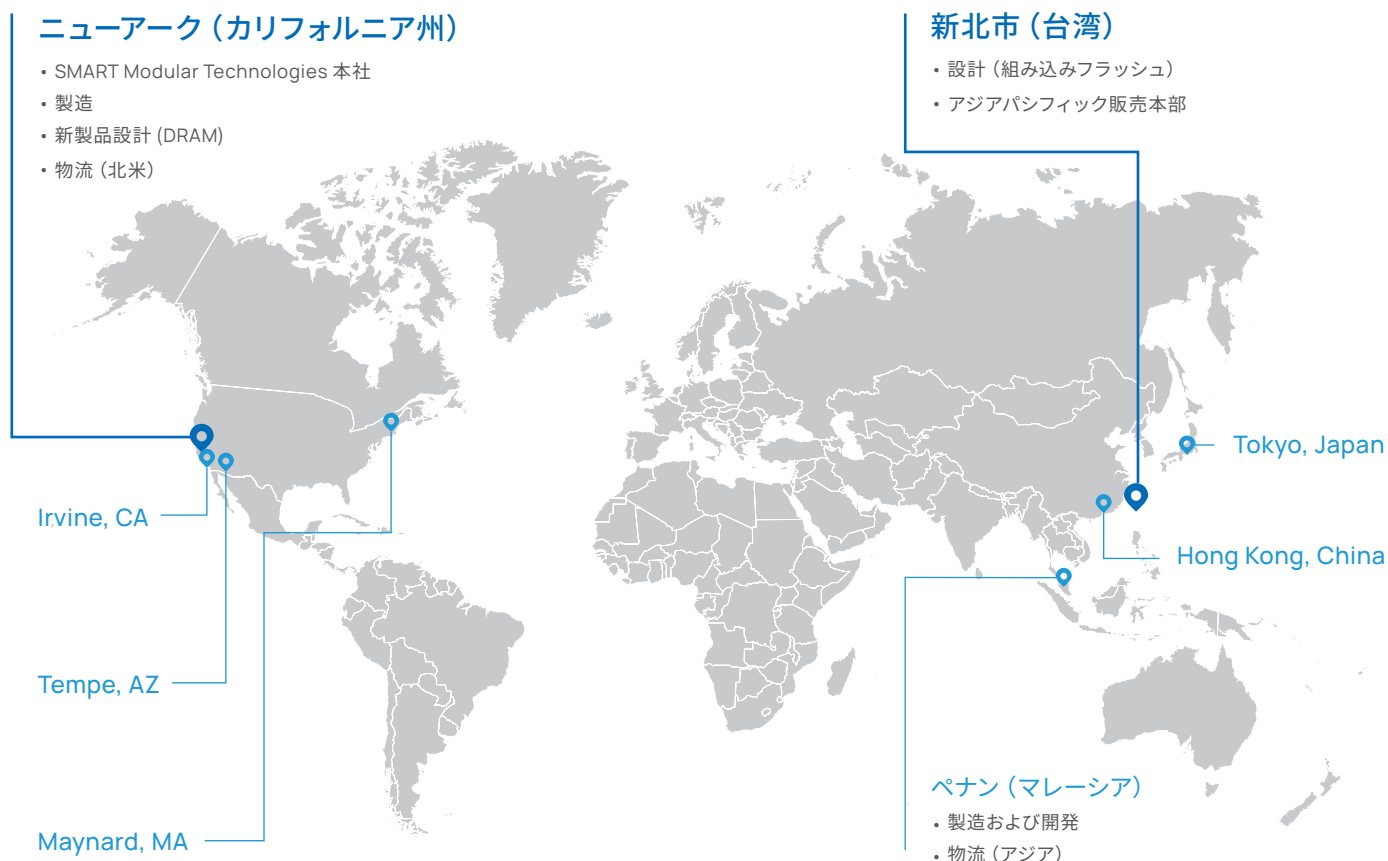
SMART Modular Technologies について

SGH(NASDAQ: SGH)の子会社であるSMART Modular Technologiesは、特殊メモリ、ストレージ、ハイブリッドソリューションにおけるグローバルリーダーであり、30年以上にわたってエレクトロニクス業界にサービスを提供しています。SMART Modular Technologiesは、標準製品群、高耐久性製品群に加えて、コンピューティング、ネットワーク、通信、ストレージ、モバイル、軍事、防衛、航空宇宙、産業市場など、さまざまな用途向けのカスタム設計を提供しています。広範な顧客固有の設計機能、技術サポート、および付加価値テストサービスの提供に重点を置き、設計プロセス全体と複数のプロジェクトにわたって、グローバルOEM顧客と緊密に連携して、差別化された要件を持つ要求の厳しい用途向けに信頼性と効率性の高いソリューションを構築しています。

SMART Modular Technologies を選ぶ理由

- **30年以上にわたり業界にサービスを提供**：主要なOEM向けの特種メモリ、フラッシュストレージ、ハイブリッドソリューションに特化しています。
- **品質保証付きの高度な製品**：設計段階から製造、サプライチェーンまで技術革新を起こします。
- **信頼できる顧客との関係**：特定の顧客に向けた設計能力、技術サポート、試験サービス。
- **ライフサイクル管理による受注生産**：すべての市場およびテクノロジー サイクルにおける長期的かつ継続的なサポート。
- **多様な産業分野における幅広い顧客基盤**：データセンター、ストレージサーバー、HPC、エッジコンピューティング、IIoT、ネットワークワーキング、産業市場が含まれます。

SMART Modular グローバルフットプリント



DuraMemory™

産業ワークロード用の耐久性と信頼性の高いメモリ

DuraMemoryポートフォリオは、今日の要求の厳しい産業仕様や用途のニーズを満たすために、優れたレベルの品質、耐久性、信頼性を実現します。

すべてのDuraMemory製品は、設計、製造、試験、物流サポートにおけるSMART Modular Technologiesの広範な専門知識によって支えられています。DuraMemory製品群は、さらなる信頼性とセキュリティを備えています。これらの製品は、耐久性と信頼性において最高水準の性能を発揮すると同時に、産業の作業負荷要件を満たし、期待以上の性能を発揮します。

高い信頼性を実現する
エンタープライズ品質

トリプルストレス試験とバー
ンインを実施

暗号化およびその他の機能が
利用可能



DuraMemory 製品群 DDR5 / DDR4 / DDR3



NVDIMM



LRDIMM



RDIMM



UDIMM



SODIMM



Mini DIMM



XRDIMM



MIP™

■ サーバー/データセンター



DIMM Type	RDIMM		LRDIMM
Technology	DDR5	DDR4	DDR4
Density	16GB-64GB	4GB-256GB	64GB-256GB
Height	31.25mm	31.25/24.4mm	31.25mm
Configuration	80bit	72bit	72bit
Speed (MT/s)	4800	2666-3200	2666
Voltage	1.1V	1.2V	1.2V
Operating Temperature*	C Temp	C/I Temp	C Temp

■ ブレード/コンパクトサーバー



DIMM Type	VLP RDIMM		VLP/ULP Mini RDIMM	
Technology	DDR5	DDR4	DDR4	DDR3
Density	32GB	4GB-64GB	8GB-32GB	2GB-8GB
Height	18.75mm	18.75mm	18.75/17.78mm	18.75/18.3/17.78mm
Configuration	80bit	72bit	72bit	72bit
Speed (MT/s)	4800	2666-3200	2666-3200	1333-1600
Voltage	1.1V	1.2V	1.2V	1.35V/1.5V
Operating Temperature*	C Temp	C/I Temp	C Temp	C/I Temp

■ ネットワーキング



DIMM Type	UDIMM		UDIMM ECC	
Technology	DDR5	DDR4	DDR5	DDR4
Density	8GB-32GB	4GB-32GB	16GB	4GB-32GB
Height	31.25mm	31.25mm	31.25mm	31.25mm
Configuration	64bit	64bit	72bit	72bit
Speed (MT/s)	4800	2666-3200	4800	2666-3200
Voltage	1.1V	1.2V	1.1V	1.2V
Operating Temperature*	C Temp	C/I Temp	C Temp	C/I Temp

*C Temp (0°C to +70°C); I Temp (-40°C to +85°C)



DIMM Type	SODIMM		SODIMM ECC		SODIMM ECC
Technology	DDR5	DDR4	DDR4	DDR3	DDR3
Density	8GB-32GB	2GB-32GB	4GB-32GB	2GB-16GB	2GB-8GB
Height	30mm	30mm	30mm	30/25.4mm	30mm
Configuration	64bit	64bit	72bit	72bit	72bit
Speed (MT/s)	4800	2400-3200	2666-3200	1600-1866	1600
Voltage	1.1V	1.2V	1.2V	1.35V/1.5V	1.35V/1.5V
Operating Temperature*	C Temp	C/I Temp	C/I Temp	C/I Temp	C/I Temp

コンパクトシステム



DIMM Type	VLP UDIMM	VLP/ULP UDIMM ECC	
Technology	DDR3	DDR4	DDR3
Density	4GB-8GB	16GB-32GB	4GB-8GB
Height	18.3mm	17.78mm	18.75/18.3mm
Configuration	64bit	72bit	72bit
Speed (MT/s)	1600	2666-3200	1600
Voltage	1.35V/1.5V	1.2V	1.35V/1.5V
Operating Temperature*	C Temp	C/I Temp	C Temp

航空宇宙/軍事



DIMM Type	XRDIMM ECC	SODIMM ECC	
Technology	DDR3	DDR4	DDR3
Density	2GB-8GB	4GB-32GB	2GB-16GB
Height	38mm	30mm	30/25.4mm
Configuration	72bit	72bit	72bit
Speed (MT/s)	1333 - 1600	2666-3200	1600-1866
Voltage	1.35V/1.5V	1.2V	1.35V/1.5V
Operating Temperature*	C/I Temp	C/I Temp	C/I Temp

*C Temp (0°C to +70°C); I Temp (-40°C to +85°C)

産業用温度 (-40°C to +85°C)

I Temp Server DIMM



DIMM Type	RDIMM		VLP RDIMM		VLP/ULP Mini RDIMM
Technology	DDR4	DDR3	DDR4	DDR3	DDR3
Density	4GB-256GB	2GB-32GB	4GB-64GB	4GB-16GB	2GB-8GB
Height	31.25/24.4mm	30mm	18.75mm	18.75mm	18.75/18.3/17.78mm
Configuration	72bit	72bit	72bit	72bit	72bit
Speed (MT/s)	2666-3200	1333-1866	2666-3200	1600-1866	1333-1600
Voltage	1.2V	1.35V/1.5V	1.2V	1.35V/1.5V	1.35V/1.5V
Operating Temperature	I Temp	I Temp	I Temp	I Temp	I Temp

I Temp UDIMM



DIMM Type	UDIMM		UDIMM ECC
Technology	DDR4	DDR3	DDR4
Density	4GB-32GB	2GB-8GB	4GB-32GB
Height	31.25mm	30mm	31.25mm
Configuration	64bit	64bit	72bit
Speed (MT/s)	2666-3200	1600-1866	2666-3200
Voltage	1.2V	1.35V/1.5V	1.2V
Operating Temperature	I Temp	I Temp	I Temp

I Temp SODIMM



DIMM Type	SODIMM		SODIMM ECC	SORDIMM ECC
Technology	DDR4	DDR3	DDR4	DDR3
Density	2GB-32GB	128MB-16GB	4GB-32GB	2GB-16GB
Height	30mm	30mm	30mm	30/25.4mm
Configuration	64bit	64bit	72bit	72bit
Speed (MT/s)	2400-3200	1600-1866	2666-3200	1600-1866
Voltage	1.2V	1.35V/1.5V	1.2V	1.35V/1.5V
Operating Temperature	I Temp	I Temp	I Temp	I Temp

I Temp VLP/ULP UDIMM



DIMM Type	ULP UDIMM ECC	VLP/ULP Mini UDIMM ECC
Technology	DDR4	DDR4
Density	16GB-32GB	4GB-32GB
Height	17.78mm	18.75/17.78mm
Configuration	72bit	72/64bit
Speed (MT/s)	2666-3200	2400-3200
Voltage	1.2V	1.2V
Operating Temperature	I Temp	I Temp



メモリの信頼性障害を90%以上排除するZefr (Zero Failure Rate ゼロ故障率)

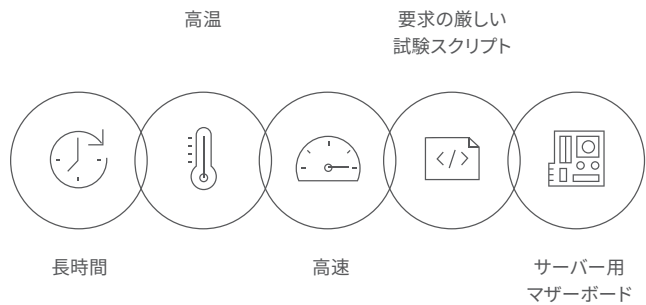
Zefrとは、要求の厳しいワークロードに対して非常に高い信頼性を提供するために、OEMのオリジナルメモリモジュールまたは SMART Modular Technologiesで構築されたメモリモジュールに対して実行するスクリーニングプロセスです。

業界標準のメモリの信頼性では不十分



Zefr Screens Memoryを現実世界の条大1件に

Zefrメモリは、脆弱なメモリモジュールを除外するために強力に処理されています。Zefrプロセスでは、5つの主要な試験要素を組み合わせています。



詳細については、<https://www.smartm.com/technology/Zefr>をご覧ください。

Zefr の利点

ROIの向上

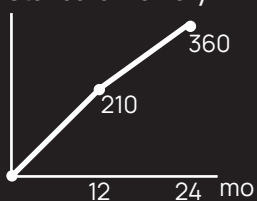
システム歩留まり率の
最大化

「洞察を得られるまでにかかる
時間」を短縮

事例研究

HPC システムインテグレーターは、標準メモリと Zefr メモリを使用して同一のシステムを構築しました

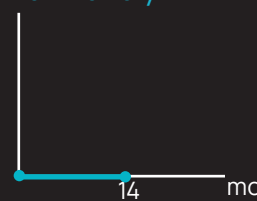
Standard Memory



18,384 個の標準 RDIMM を購入
クラスター A を構築：
1,532 ノード
ノードあたり 12 個の 16 GB RDIMM

プラットフォームが起動してからの
フィールド障害：
360 件の障害

Zefr Memory



18,384 個の標準 RDIMM を購入
クラスター B を構築：
1,532 ノード
ノードあたり 12 個の 16 GB RDIMM

プラットフォームが起動してからの
フィールド障害：
0 件の障害



世代DDR5

高性能コンピューティングの進歩

オンボードの12V統合電圧レギュレーターにより、
シグナルインテグリティの向上とノイズの低減を
実現

デュアル40ビット幅チャンネルアーキテクチャにより、
メモリ効率の向上とレイテンシの短縮を実現

READデータフレームでCRC
チェックサムを生成

各チャンネルの独立したクロックにより、
シグナルインテグリティの向上とノイズマージンの低下を実現

オンダイECCにより、DDR5メモリアレイ内の
シングルビットエラーに対する保護を強化

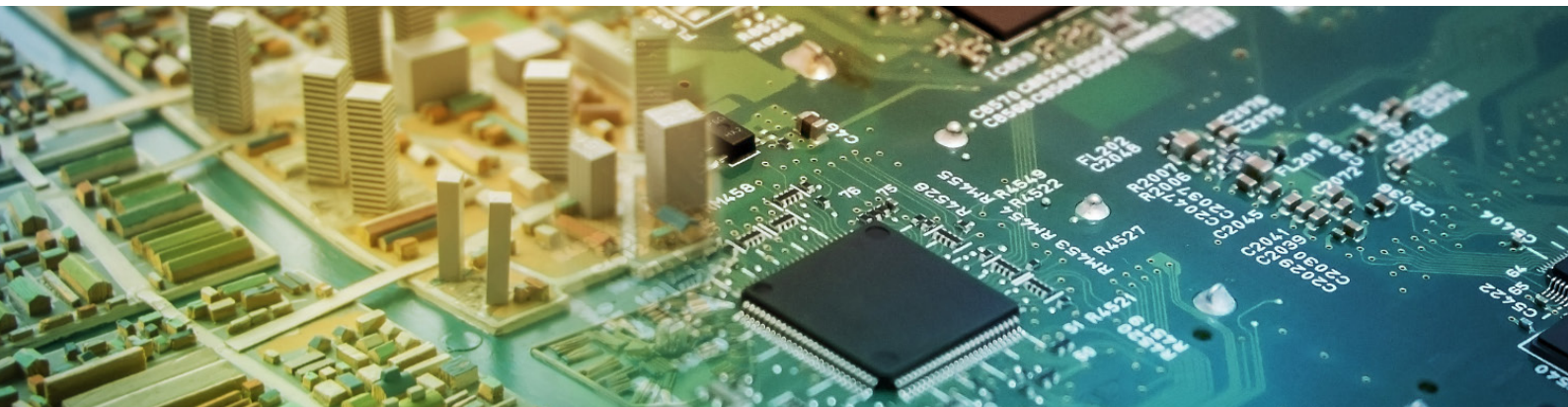
DuraFlash™

耐久性と信頼性の高いフラッシュソリューション

SMART Modular Technologiesでは、DuraFlashを使用して、テレコム、ネットワークング、ストレージ、産業用制御、医療、IIoT、輸送、ビデオ監視市場セグメントにおいて、組み込み用途の加速という大きな要求を満たすように設計・製造された幅広いフォームファクタのフラッシュストレージの提供に取り組んでいます。SMART Modular Technologiesでは、広範な機能と細部への配慮により、品質管理と厳格なプロセスを設計、調達、製造サイクルのあらゆる側面に統合しています。このプロセスは、SMART Modular Technologiesの厳しい要件を満たす専門の材料およびコンポーネントを提供するサプライヤーの選択から始まり、完成品に至ります。そして、すべてのユニットが基準の広範なチェックリストに合格することを要求する厳格な設計検証テスト(DVT)プロセスと、リリースのための最終検査を受けます。

付加価値機能

- エンタープライズおよび産業用途向けに最適化
- C温度(0°C~+70°C)およびI温度(-40°C~+85°C)で利用可能
- 複数のNANDオプション:TLC/eTLC/MLC/SLC/pSLC
- フィールドの信頼性を保証する広範なバーニン
- 高度な機能と共にカスタマイズオプションが利用可能
- SafeDATA™テクノロジーにより、突然の電源喪失(SPL)時に転送中のデータを保護
- 幅広い容量で利用可能



DuraFlash 製品群



DuraFlash
SSDs

- 2.5"
- M.2 (2242/2280/22110)
- mSATA
- Slim SATA



DuraFlash
BGA

- eMMC



DuraFlash
Cards

- SD Cards
- microSD Cards
- CF Cards



DuraFlash
USB

- eUSB
- USB Flash Drives



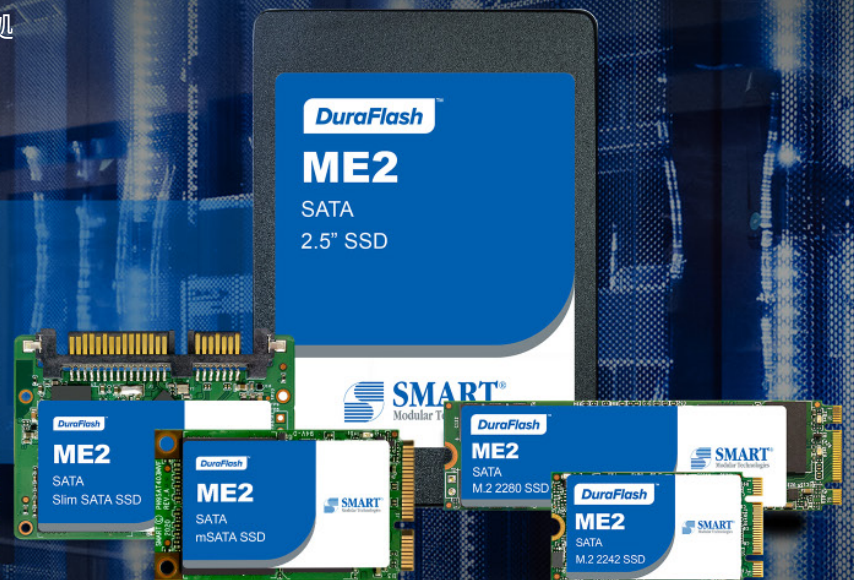
Enterprise/
Data Center SSDs

- EDSFF

データセンター向けの SSDブートドライブ

- 最新世代の 3D NAND 技術
- 1日あたり最大1ドライブの書き込み (1 DWPD) の耐久性
- SMART Modular 独自の NVMSentry™ ファームウェア
- SMART の SafeDATA™ 電力損失、データ保護技術
- AES-256 暗号化および TCG Opal 2.0 準拠
- I-Temp をサポート (-40°C~+85°C)

ME2 SATA SSDs



MP3000 PCIe NVMe SSDs

ME2 SATA SSDs



Specifications

Interface		SATA III 6Gb/s				
Form Factor		2.5	M.2 2242-D3-B-M	M.2 2280-D3-B-M	mSATA (MO-300A)	Slim SATA (MO-297)
Max. Performance	Read	540MB/s	540MB/s	540MB/s	540MB/s	540MB/s
	Write	450MB/s	450MB/s	450MB/s	450MB/s	450MB/s
Capacity		240GB-1920GB	240GB-960GB	240GB-1920GB	240GB-1920GB	240GB-1920GB
DRAM		V	V	V	V	V
Input Voltage		5V ± 10%	3.3V ± 5%	3.3V ± 5%	3.3V ± 5%	3.3V ± 5%
Data Integrity	SafeDATA	Optional	-	Optional	-	-
	Advanced Error Detection & Correction	V	V	V	V	V
Security	AES 256 Encryption	V	V	V	V	V
	TCG OPAL 2.0	V	V	V	V	V
	Security Erase (ATA)	V	V	V	V	V
Reliability	MTBF	> 2,000,000 hours				
	Shock Operating	1500 g half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction				
	Vibration Operating	20G 80-2000Hz, 1.52mm 20-80Hz, 3 axis				
Operating Temperature*		C/I Temp	C/I Temp	C/I Temp	C/I Temp	C/I Temp
Durability	DWPD (for 5 Years)	1 (Enterprise Workload)	1 (Enterprise Workload)	1 (Enterprise Workload)	1 (Enterprise Workload)	1 (Enterprise Workload)
	Pseudo-SLC	-	-	-	-	-
	Thermal Throttling	V	V	V	V	V
	Wear-Leveling / Garbage Collection / TRIM	V	V	V	V	V

推奨用途

- AI
- データセンター
- 産業
- ネットワークング
- 監視

*C Temp (0 °C to +70 °C) ; E Temp (-25 °C to +85 °C) ; I Temp (-40 °C to +85 °C)

MP3000 PCIe NVMe SSDs



Specifications

Interface		PCIe Gen4 x4		
Form Factor		EDSFF E1.S	M.2 2280-D3-M	M.2 22110-D3-M
Max. Performance	Read	3500MB/s	3500MB/s	3500MB/s
	Write	2000MB/s	2000MB/s	2000MB/s
Capacity		240GB-1920GB	240GB-1920GB	240GB-1920GB
DRAM		V	V	V
Input Voltage		12V ± 10%	3.3V ± 5%	3.3V ± 5%
SafeDATA		Optional	Optional	Optional
Data Integrity	Advanced Error Detection & Correction	V	V	V
	AES 256 Encryption	V	V	V
Security	TCG OPAL 2.0	V	V	V
	Security Erase (ATA)	V	V	V
Reliability	MTBF	> 2,000,000 hours		
	Shock Operating	1500 g half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction		
	Vibration Operating	20G 80-2000Hz, 1.52mm 20-80Hz, 3 axis		
Operating Temperature*		C/I Temp	C/I Temp	C/I Temp
Durability	DWPD (for 5 Years)	1 (Enterprise Workload)	1 (Enterprise Workload)	1 (Enterprise Workload)
	Pseudo-SLC	Optional	-	-
	Thermal Throttling	V	V	V
	Wear-Leveling / Garbage Collection / TRIM	V	V	V

推奨用途

- AI
- データセンター
- HPC
- ネットワークング
- ストレージ
- 電気通信

*C Temp (0 °C to +70 °C) ; E Temp (-25 °C to +85 °C) ; I Temp (-40 °C to +85 °C)

CS310 SATA SSDs



Specifications

Interface		SATA III 6Gb/s			
Form Factor		2.5	M.2 2242-D2-B-M	M.2 2280-D2-B-M	mSATA (MO-300A)
Max. Performance	Read	560MB/s	560MB/s	560MB/s	560MB/s
	Write	520MB/s	520MB/s	520MB/s	520MB/s
Capacity		128GB-1TB	128GB-1TB	128GB-1TB	128GB-1TB
DRAM		-	-	-	-
Input Voltage		5V ± 10%	3.3V ± 5%	3.3V ± 5%	3.3V ± 5%
Data Integrity	SafeDATA	-	-	-	-
	Advanced Error Detection & Correction	V	V	V	V
Security	AES 256 Encryption	-	-	-	-
	TCG OPAL 2.0	-	-	-	-
	Security Erase (ATA)	V	V	V	V
Reliability	MTBF	> 3,000,000 hours			
	Shock Operating	1500 g half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction			
	Vibration Operating	20G 80-2000Hz, 1.52mm 20-80Hz, 3 axis			
	Operating Temperature*	I Temp	I Temp	I Temp	I Temp
Humidity		40°C, Operation: 90% RH, Storage: 93% RH			
Durability	Pseudo-SLC	-	-	-	-
	Thermal Throttling	V	V	V	V
	Wear-Leveling / Garbage Collection / TRIM	V	V	V	V

推奨用途

- ネットワーキングルーターおよびスイッチ
- エッジコンピューティング
- ファクトリーオートメーション制御
- 輸送

*C Temp (0 °C to +70 °C) ; E Temp (-25 °C to +85 °C) ; I Temp (-40 °C to +85 °C)

CS410 SATA SSDs



Specifications

Interface		SATA III 6Gb/s			
Form Factor		2.5	M.2 2280-D2-B-M	M.2 2242-D2-B-M	mSATA (MO-300A)
Max. Performance	Read	550MB/s	550MB/s	550MB/s	550MB/s
	Write	500MB/s	500MB/s	500MB/s	500MB/s
Capacity		128GB-1TB	128GB-512GB	128GB-1TB	128GB-1TB
DRAM		V	V	V	V
Input Voltage		5V ± 10%	3.3V ± 5%	3.3V ± 5%	3.3V ± 5%
Data Integrity	SafeDATA	-	-	-	-
	Advanced Error Detection & Correction	V	V	V	V
Security	AES 256 Encryption	-	-	-	-
	TCG OPAL 2.0	-	-	-	-
	Security Erase (ATA)	V	V	V	V
Reliability	MTBF	> 1,000,000 hours			
	Shock Operating	1500 g half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction			
	Vibration Operating	20G 80-2000Hz, 1.52mm 20-80Hz, 3 axis			
	Operating Temperature*	C Temp	C Temp	C Temp	C Temp
Humidity		40°C, Operation: 90% RH, Storage: 93% RH			
Pseudo-SLC		-	-	-	-
Thermal Throttling		V	V	V	V
Wear-Leveling / Garbage Collection / TRIM		V	V	V	V

推奨用途

- POSおよびキオスク端末
- ネットワーキングルーターおよびスイッチ
- ファクトリーオートメーション制御
- エッジコンピューティング
- ゲームおよび産業用制御用のシングルボードコンピュータ

*C Temp (0°C to +70°C) ; E Temp (-25°C to +85°C) ; I Temp (-40°C to +85°C)

SD Cards



Specifications	XL+	RD230
Interface	SD 3.01	SD 6.1
Form Factor	SD Card	
NAND Type	SLC	TLC
Max. Performance	Read	49MB/s
	Write	38MB/s
Capacity	4GB-32GB	32GB-256GB
Operating Temperature*	C/I Temp	I Temp

推奨用途

- 自動車向けテレマティクス、ナビゲーション、インフォテインメント
- デジタル商用ビデオカメラ
- 電気通信 & 通信
- 組み込みコンピューティング
- 医療機器

MicroSD Cards



Specifications	RD130m	RD230m	RD530m
Interface	SD 3.01	SD 6.1	SD 6.1
Form Factor	microSD Card		
NAND Type	SLC	TLC	TLC
Max. Performance	Read	68MB/s	100MB/s
	Write	50MB/s	90MB/s
Capacity	1GB-4GB	32GB-256GB	64GB-256GB
Operating Temperature*	E/I temp	I Temp	C Temp

推奨用途

- 自動車向けテレマティクス、ナビゲーション、インフォテインメント
- 電気通信&通信
- 組み込みコンピューティング
- デジタル商用ビデオカメラ
- 工業用メーターおよび工業用制御
- 医療機器
- ゲーム

*C Temp (0°C to +70°C) ; E Temp (-25°C to +85°C) ; I Temp (-40°C to +85°C)

CF Cards



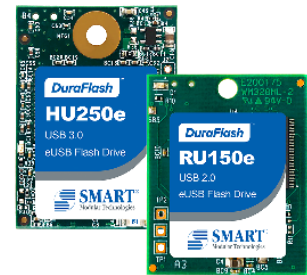
Specifications	H9	XL
Interface	CF 6.1	CF 4.1
Form Factor	CompactFlash	
NAND Type	SLC	
Max. Performance	Read	100MB/s
	Write	70MB/s
Capacity	64MB-64GB	128MB-8GB
Operating Temperature*	C/I Temp	C/I Temp

推奨用途

- ・ ゲーム
- ・ 通信
- ・ 防衛
- ・ 産業用制御機器
- ・ ネットワーキング
- ・ プリンター

eUSB Flash Drives

Specifications	RU150e	HU250e
Interface	USB 2.0	USB 3.0
NAND Type	SLC	
Max. Performance	Read	35MB/s
	Write	27MB/s
Capacity	1GB-32GB	8GB-32GB
Operating Temperature*	C/I Temp	I Temp
Connector	Pin pitch 2.54mm, H: 7.50mm Pin pitch 2.54mm, H: 9.78mm Pin pitch 2.00mm, H: 3.68mm	Pin pitch 2.00mm, H: 3.68mm Pin pitch 2.54mm, H: 7.42mm



推奨用途

- ・ 防衛、ゲーム、産業用制御用途向けのシングルボードコンピュータ
- ・ ATCAコンピューティングブレード
- ・ 業界向け標準サーバー

*C Temp (0°C to +70°C) ; E Temp (-25°C to +85°C) ; I Temp (-40°C to +85°C)

次世代データセンター SSD

データセンター用途の3つの主要な要求に対応

SMART Modular Technologiesの次世代SSD製品群は、要求の厳しい用途や厳格なSLA向けに設計されています。今日のコンピューティング用途では、データセンターサーバーに対して過酷な要求を行い、基盤となるハードウェアに対して、ますます継続的で信頼性の高い性能を要求しています。データへの頻繁なアクセスを要求するサービスレベルアグリーメント(SLA)に対応するには、SSDストレージコントローラーの設計が重要です。

低消費電力向けの設計

SMART Modular Technologiesの次世代SSD製品群は、最大性能を維持しながらより低温で動作するハードウェアアクセラレーションアーキテクチャを採用しています。低電力動作により、省エネルギー基準を達成し、1平方フィートあたりのサーバー密度も向上します。標準の2U/24構成で、サーバーあたり最大200Wの消費電力を節約できます。



ピーク性能



低消費電力



エンタープライズ機能

SMART Modular TechnologiesのデータセンターSSDは、スループットを最大化するためにフルスロットルで動作します。

	リード	ライト
シーケンシャル (GB/s)	7.1 GB/s	4.6 GB/s
ランダム (KIOP/s)	1,490	180

SMART Modular Technologiesの低電力アーキテクチャにより、SSDは常に低温で動作します。

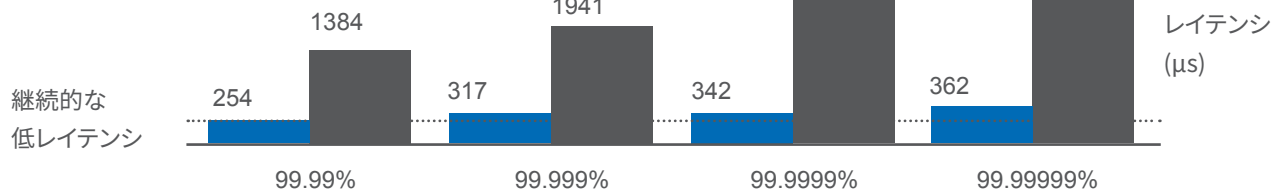
- 業界をリードする低アイドル電力とアクティブ電力
- 発生する熱が少ないため、NANDが高速に動作するためのヘッドルームが増大
- SSDと冷却のOpExコストを削減

当社のSSDは、さまざまなデータセンター用途向けに設計されています。

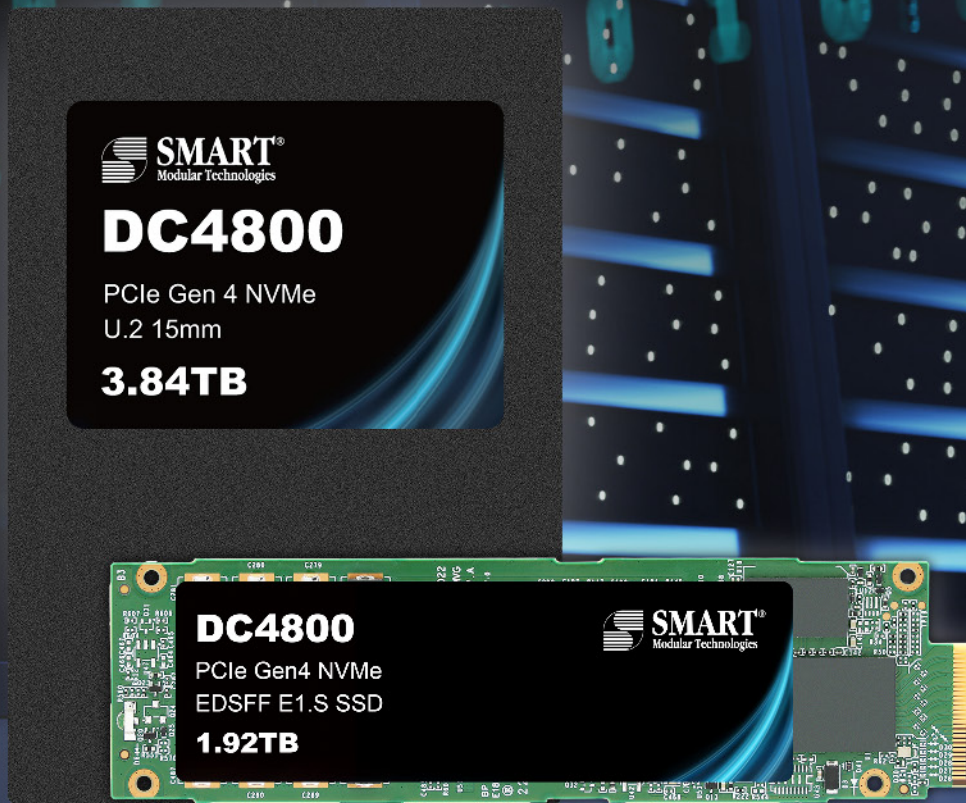
- E2Eデータ保護、TCG、OPAL、eDriveセキュアプラットフォームブート
- 複数の名前空間
- 1および3 DWPD
- SMART/ヘルスログ
- テレメトリ
- 外部電源喪失保護

SMART DC4800 SSDs

競合他社のSSD



70/30 ランダム 4KRW のレイテンシパーセンタイル



DC4800 PCIe NVMe データセンター SSD

高速、クール、一貫性

データセンター、ハイパースケーラー、
クラウドサーバー用途向けに設計

サーバーの PCIe Gen 3/4/5 を完全に
飽和させることができる持続的な最大性能

99.99999% のレイテンシの一貫性を備えた
優れたサービス品質 (QoS)

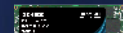
ハードウェアアクセラレーション SSD 設計により、
サーマルスロットリングが大幅に削減され、
IOP とスループットが 15~20% 向上

DC4800 製品群

Form Factor	Capacity
U.2	1.92TB, 3.84TB, 7.68TB
EDSFF E1.S	1.92TB, 3.84TB, 7.68TB



U.2



EDSFF E1.S



Think Memory. Think SMART.

製品の詳細については、smartm.com/jpにアクセスするか、
SMART Modular Technologiesの営業チームにお
問い合わせください。

*製品画像はプロモーション目的でのみ使用されます。
ラベルは実際の製品を表していない場合があります。

本社

39870 Eureka Dr. Newark CA 94560

☎: (+1) 510-623-1231

☎: (+1) 510-623-1434

✉: info@smartm.com

台湾支社

6F, Unit A, No. 1, Yuan Dong Rd.,

Banqiao District, New Taipei City 220, Taiwan, R.O.C.

☎: (+886) 2-7705-2700

☎: (+886) 2-7705-2701

✉: sales.asia@smartm.com

JAPAN

Komiya Yuji

☎: (+81) 80-4002-9661

✉: komiya.yuji@smartm.com



www.smartm.com/jp



Follow us on LinkedIn

©2024, SMART Modular Technologies. All rights reserved. The stylized "S" in conjunction with "SMART", as well as "SMART Modular Technologies" are registered trademarks of SMART Modular Technologies. All other trademarks are the property of the respective owners. These materials are provided by SMART Modular Technologies as a service to its customers and may only be used for informational purposes. 12.08.23/Brochure_JP/Rev.1

